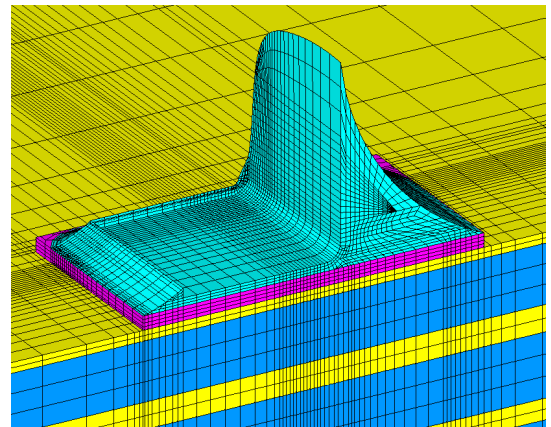
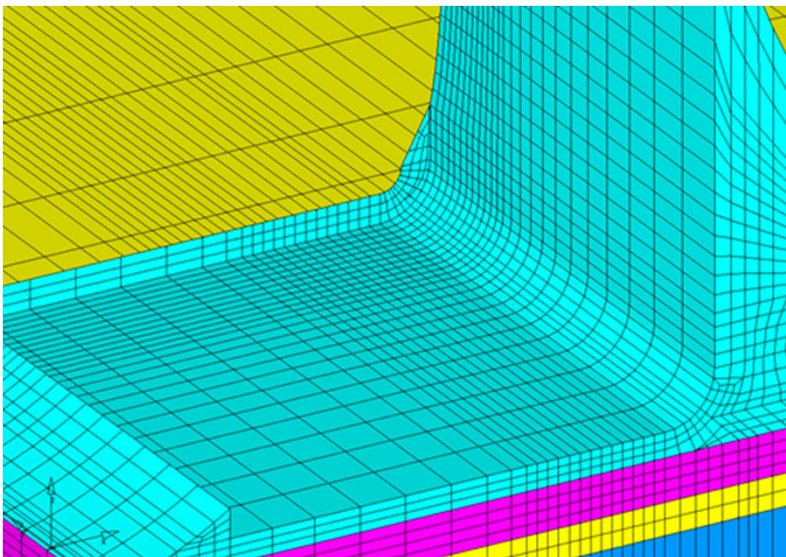
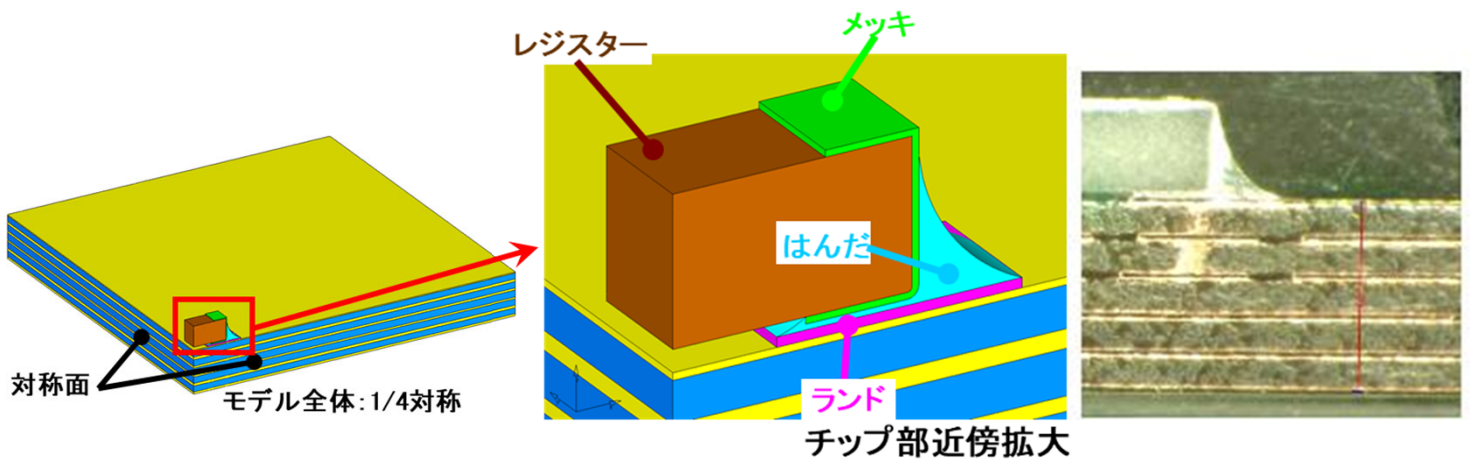


はんだ接続部の熱応力解析 (CAE)



チップコンデンサのはんだ部は熱サイクルによってひずみ集中し、しばしば損傷を生じるため、当該部の発生応力やひずみを予測することが望まれます。それには、有限要素法による数値解析が有力な手段であり、まず、はんだ周囲の部材を含んだ解析用モデルを作成します。

<解析モデル：3次元・1/4対象モデル>



はんだ-メッキ界面拡大：最小要素寸法 $3\mu\text{m}$
(メッキ下はんだ厚さ $10\mu\text{m}$)

この技術資料に関するお問い合わせは、最寄り営業担当に連絡いただくか、もしくは弊社問合せ窓口までお知らせください。
。 mailto:inquiry_eigyo@kki.kobelco.com